

DNPグループ IR-Day 2024 質疑応答要旨
(2024年7月11日)

【質問者1】

Q：プレゼンテーション資料7ページに記載のメタルマスク売上高のCAGR（年平均成長率）について+8.3%を見込んでいるが、OLEDスマートフォン向けパネル、タブレット/ノートPC生産台数の見通し等を考慮すると、それ以上の伸びが期待される。貴社がCAGR+8.3%と見込んだ詳細について数量・単価別に教えてほしい。また第8世代の開発案件需要による売上増は大きく見込んでいないのか教えてほしい。

A：23年度は、タブレット関連の開発品の特需があり、大きく売上高を伸ばしましたが、実際には段階的に推移しています。メタルマスクはパネル1台につき一つ使用される訳ではなく、あくまで治具ですので、得意先の開発品・量産品の品種数等によって当社の売上は変動します。そのため事業計画は得意先の開発計画等を鑑みて作成しています。また単価等については、公表を控えます。黒崎工場（福岡県）の第8世代の試作および一部生産は始まりませんが、現在は三原工場（広島県）のラインで供給は賄える状況です。得意先の計画にもよりますが、まだ今年度、来年度に量産が見込める状況ではありません。

Q：EUVマスクは、現状半導体メーカーが内製しているとの説明があった。今後、貴社が外販メーカーとしてEUVマスクを納めるのか、あるいは貴社のナノインプリント技術によって半導体メーカーのEUVマスク製造をサポートする事業を行うのか、貴社のEUVマスク関連の売上内容を改めて教えてほしい。またIBMの技術を使用するラピダス社の製造プロセスについてEUVマスク製造を行う競合他社がIBMの技術の流れを汲んでいるため親和性があると思われるが、貴社は十分に参入できるのか教えてほしい。

A：ご理解の通り、現在EUVマスクは半導体メーカーが自社で製作するのが主流ですので、現時点で当社は周辺の装置メーカー、材料メーカーに評価用、基準マスク用としてEUVマスクを納品しています。今後は量産用EUVマスクの販売先としてラピダス社が第一候補であり、後続の得意先が出てくることを期待しています。また、EUVマスクを内製するメーカーに向けて、ナノインプリント等の技術により、EUVマスクのチップコストを下げるソリューションを提供する事業を考えています。当社もラピダス社の使用するIBMのプロセスに、完全ではないにしても合わせる必要がありますが、2ナノマスクのプロセス技術に関しては目途が立っており、またEUVマスクは検査・修正

技術に改善の余地がありますので、当社は、適正な品質保証を含めた生産技術の確立に注力していきます。

Q : バッテリーパウチについて、EV のバッテリーに使用されるパウチを 100 とすると、プラグインハイブリッドでは 1 台当たりどれぐらいの使用量になるのか教えてほしい。また、昨今リチウムイオンバッテリーの価格が下落していると理解しているが、バッテリーパウチの販売価格の見通しは変化しているのか、変わらない場合は、価格を維持できる貴社の競争力を教えてほしい。

A : EV のバッテリーパウチに使用されるパウチを 100 とした場合、当社の試算では PHEV (プラグインハイブリッド) は 25、HEV (ハイブリッド) は 2 程度となります。ただしパウチを使用した PHEV や HEV は増加見込ですので、当社の売上に一定程度寄与するものと考えています。現状、欧米向けに圧倒的なシェアを持っているなかで、それほど大きな価格の下落はありませんが、競合が現れたときのために価格競争力を高める方策をとるとともに、特許の活用等で当社の強みを維持できる方策を検討してまいります。

【質問者 2】

Q : 現在の事業ポートフォリオの考え方、経営効率を上げていくための事業の選択と集中をどのようにイメージされているか教えてほしい。

A : 現在の事業ポートフォリオの中には、良い分野、悪い分野は確かにありますが、各事業分野の中身を見ながら事業ポートフォリオは絶えず変革していきます。低収益部門については、競争力が弱くなった分野は撤退も考えますが、競争力の強い分野に注力して利益率を高めていく仕掛けを検討するほか、人材のリスキリングを行い新しい分野へ配置転換する等の施策を続けていきます。

Q : コンテンツ・XR コミュニケーション事業について、海外向けのコンテンツ売上を伸ばすと言われているが、どの国に具体的に何を売るとか、その準備ができているのかを教えてください。また XR 事業ではどういうものが売上につながるのかを教えてください。

A : 北米を中心に、各種大型イベントの企画展示の運営や、オリジナルの商品開発ならびに販売をしています。また自主事業としてサンフランシスコに「東京アニメセンター」を 2024 年 4 月にオープンしました。得意先と協業し、カプセルトイ等の様々な日本発の商品・サービスを北米に展開していく予定です。その他、コンテンツ創出後の展開や、ファンやコンテンツの特性に合

わせて、新規ファンの獲得や既存ファンの深耕につながるよう、国別、地域別の展開を検討していきます。XR 事業については、エンタテインメント分野から教育分野、工場や医療などの産業分野へ進出していく予定です。具体的な取組みとして、東京都の 30 の自治体で利用されている不登校メタバースや、XR 空間の中で役所の相談業務を行うメタバース役所の展開を始めています。

Q：光学フィルムについて、フィルム基材（TAC、アクリル、PET）の現在の市場の構成割合と今後の見通しについて、教えてほしい。また貴社の光学フィルムの市場シェアが上がっていると思うが、今後の継続性について教えてほしい。

A：市場全体のテレビの中に使われるフィルム半数超が PET の基材を使用しています。今後については PET 基材メーカーが生産性を向上していくことでシェアを上げていくことになると考えています。また、2023 年度に競合の韓国メーカーが中国企業に事業を売却した影響により、その競合が製造していた表面材の多くを DNP が生産性を高めて対応したことで市場シェアが非常に高くなりました。長期的には得意先と契約等を結ぶことで安定的にシェアを維持・拡大していくことを考えています。

【質問者 3】

Q：北島社長のプレゼンテーション資料 2 ページに記載の資本効率の向上の箇所について、自己株式の取得、増配、ノンコア・不採算部門のカーブアウト、政策保有株式の縮減等の 5 つの施策に優先順位があるか、教えてほしい。

A：当社は現在、自己株式の取得を最優先で行っています。当初の計画として 5 年間で 3,000 億円の自社株買いの達成を掲げ、現在 1,500 億円の目標を目指して進めているところですが、残りの 1,500 億円を達成してから増配や不採算部門のカーブアウト等を検討していく計画です。政策保有株式の縮減や遊休不動産の売却については現在も並行して行っています。ただし当社の置かれた状況・条件によっては 3,000 億円の達成前に並行してその他の施策に着手する場合もあります。

Q：バッテリーパウチについて、2025 年に北米の車載用バッテリーメーカーが OEM 製造の増産に向けた新工場稼働を開始するとされているが、貴社の供給能力の準備状況や新規の大規模投資の必要性について、教えてほしい。また工場の稼働の延期や規模の縮小となった場合のリスクヘッジ策について教えてほしい。

A：現在投資している範囲内で当社の生産キャパシティは、問題ないと考えてい

ます。一部の工場の稼働の延期やEV、PHEV、HEVの販売状況によっては稼働率の変動する可能性もありますが、稼働状況を十分見極め、最適な人員体制や生産体制を随時組んで対応していきたいと考えています。

Q：メタルマスクについて、黒崎工場が稼働したことで生産能力が2倍になるとのリリースであるが、2年後にはまだそのキャパシティを活用しきれない見込である。それにもかかわらず、2024年時点で設備投資を行った背景と、2倍となったキャパシティを十分に活用できる時期をいつ頃と見込んでいるのか、教えてほしい。

A：メタルマスクのラインは、段階的に生産能力を上げていくものではなく、全ての工程を整えて生産開始する必要があります。また、第8世代への投資が決定している得意先に対して、タイムリーに開発品やサンプル品を提供するために先行投資しました。さらに、十分なキャパシティを確保することで競合他社に参入の余地を与えないこと、BCP（事業継続計画）の観点から従来の三原工場以外に生産体制を確保することを考えてこのタイミングで投資を行いました。フル稼働の時期は、現在のスマートフォンの約50%超がLCDからOLEDパネルに置き換わり、タブレット/ノートPC向け、車載向けのOLEDパネルの採用が検討される2026年より先の時期を計画しています。

【質問者4】

Q：メタルマスクについて、今後IT製品が第8世代に移行すると他社の参入リスクが上がるのか、貴社の技術の優位性と競争環境について教えてほしい。また貴社のインバー材の特許は当分切れることはないのか、教えてほしい。

A：当社はインバー材の特許を有しており強い競争力を有しています。こちらは当分切れることはありません。パネルサイズが大きくなると高精細なファインピッチを求められないことから、各社でOLEDパネルの製造にメタルマスクを使用しない蒸着方式や印刷方式等が検討されていますが、工程が長くなり歩留まりに影響する等、多くの課題が残っている状況です。当社は技術の置き換えが無いが、色々な情報を入手していますが、現時点ですぐにメタルマスク方式に変わる状況ではないと考えています。また、他の製造方法のメリットに対抗できるようにメタルマスク方式での更なる高精細化に向けて技術開発・向上を行っています。

Q：ナノインプリントについて、従来から取り組んでいるものの進展が無いように思われるが、技術的な課題と直近の進展があれば教えてほしい。また得意先の数やアプリケーション（メモリ・ロジック）について教えてほしい。

A：ナノインプリントは半導体のプロセスを大きく変えてしまうので、ターゲットとする製品の投入時期、設備の置き換え等を長期間で計画しなければなりません。その計画の過程で材料や装置価格の変化等によりナノインプリント技術を使用するターゲット製品が変化してきているのが、遅延している要因と考えています。2030年の40億円の売上目標については、今までキオクシアとキヤノン向けに共同開発を行い、キオクシア向けに集中開発してきましたが、三者で合意してキオクシア以外にも販路を広げることになりました。個別の得意先については公表を避けますが、キオクシア以外から具体的なナノインプリントの引き合いが増えてきています。アプリケーションについてはメモリ・ロジック共にあります。

Q：ガラスコアについて、貴社の事業範囲およびガラスコアの技術的な手応えについて教えてほしい。

A：ビアに銅を埋めるところが当社の持っている強みを活かすプロセスだと考えています。前工程のガラスへの穴あけについては、今後当社でも形成技術を作っていきたいと考えています。後工程の配線については、当社がその基板を半導体パッケージメーカーに販売し、メーカーが配線加工を施し、最終的にOSATでチップを載せて半導体パッケージにしていくサプライチェーンを考えています。昨今は生成AI等の進展で、チップ内部の高密度化だけではなく、複数のチップを一個のパッケージするチップレット化の流れがあります。チップレット化の技術的ハードルとなっていた従来の有機基板で起こる反りや歪みが、ガラスコア基板の剛性、平坦である特性により解消しチップレット化が容易になるので、この技術が注目されていると当社は判断しています。

以上